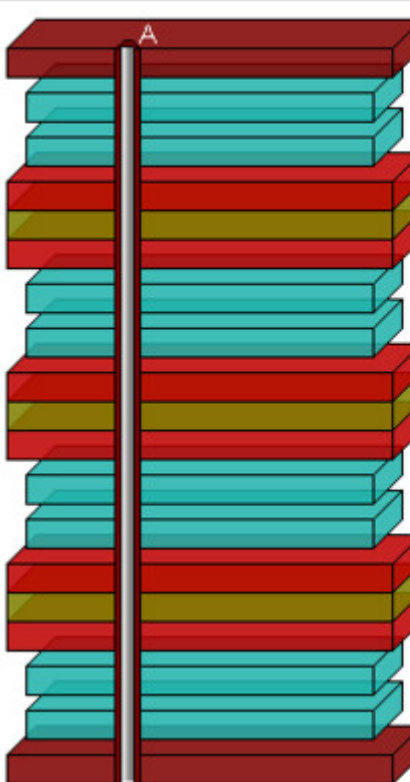


Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ	
1		Cu+galv.Cu		18+25		
		Prepreg	0.068		1080	
		Prepreg	0.068		1080	
2		Cu		35		
		Tr-Lam	0.25			
3		Cu		35		
		Prepreg	0.068		1080	
4		Prepreg	0.068		1080	
		Cu		35		
5		Tr-Lam	0.25			
		Cu		35		
6		Prepreg	0.068		1080	
		Prepreg	0.068		1080	
7		Cu		35		
		Tr-Lam	0.25			
8		Cu		35		
		Prepreg	0.068		1080	
9		Prepreg	0.068		1080	
		Cu+galv.Cu		18+25		

Presslingsdicke *	1,50	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske *	1,61	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Leiterbild Außenlagen	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Standard	
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 190 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 240 µm
Leiterbild Innenlagen	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm